

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于安集微电子科技有限公司（上海）股份有限公司
2026年半年度持续督导跟踪报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对安集微电子科技有限公司（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技”、“公司”）开展持续督导工作，并出具2026年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导工作情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并制定了相应工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与安集科技签订了保荐协议，明确双方在持续督导期间的权利义务
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2026年半年度持续督导期间，公司未发生需按有关规定公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2026年半年度持续督导期间，安集科技及相关当事人不存在违法违规和违背承诺的情况
6	督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	2026年半年度持续督导期间，安集科技及其董事、高级管理人员无违法违规和违背承诺的情况

7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东会、董事会议事规则以及董事、高级管理人员的行为规范等	公司章程、议事规则等制度符合相关法规要求,持续督导期间,公司有效执行了相关治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	安集科技内控制度符合相关法规要求,可以保证公司的规范运行,督促公司严格执行内部控制制度
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	公司已按照证券监管部门的相关要求建立了信息披露制度。2026年半年度持续督导期间,安集科技向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充,公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告;对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	2026年半年度持续督导期间,保荐机构对安集科技的信息披露文件及向上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅或者在规定期限内进行事后审阅,公司给予了积极配合。截至本报告出具日,不存在因信息披露出现重大问题而需要公司予以更正或补充的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正	在2026年半年度持续督导期间,安集科技或其控股股东、董事、高级管理人员人员未发生受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	2026年半年度持续督导期间,安集科技及控股股东不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	2026年半年度持续督导期间,未发现安集科技该等事项

14	发现以下情形之一的,督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形;(四)公司不配合持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	本督导期内,安集科技未发生该等情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划,并明确了现场检查工作要求
16	持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项。	2026年半年度持续督导期间,保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注

二、保荐机构对公司信息披露审阅的情况

保荐机构持续督导人员对公司2026年半年度的信息披露文件进行了事先或事后审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查,保荐机构认为,安集科技严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露,依法公开对外发布各类定期报告或临时报告,确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

四、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下:

(一) 产品开发风险

公司产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域,对于产品技术创新要求较高。在下游产品不断提出更高技术要求的前提下,对上游关键半导体材料的要求也在不断提高,公司需要对客户需求进行持续跟踪研究并开发满足客户需求的

产品。如果公司未来不能准确地把握技术发展趋势，在产品开发方向的战略决策上出现失误，或者未能及时进行产品升级和新技术的运用，将使得公司产品开发的成功率受到影响，持续大量的研发投入成本无法回收，进而对公司经营造成不利影响。

（二）核心技术失密及核心技术人员流失的风险

公司产品技术壁垒高，研发及产业化需要大批专业背景深厚、实践经验丰富的高层次技术人才。公司核心技术涵盖了整个产品配方和工艺流程，核心技术人员对公司持续科技创新及客户技术支持服务至关重要。虽然公司通过申请专利或者技术秘密等形式对核心技术予以保护，但仍存在核心技术失密的风险。随着行业内人才竞争日趋激烈，如果公司的薪酬制度、激励机制不能持续保留和吸引优秀人才，可能会导致公司的核心技术人员流失，进而对公司的核心竞争力和业务发展产生不利影响。

（三）客户集中度较高风险

2026 年上半年，公司向前五名客户合计的销售额占当期销售总额的百分比为 71.48%。公司销售较为集中的主要原因系国内外集成电路制造行业本身集中度较高、公司产品定位领先技术的特点和“本土化、定制化、一体化”的服务模式等，且公司主要客户均为国内外领先的集成电路制造厂商。如果公司的主要客户流失，或者主要客户因各种原因大幅减少对公司的采购量或者要求大幅下调产品价格，公司的经营业绩可能出现下降。

（四）原材料供应及价格上涨风险

如果公司主要供应商的供货条款发生重大调整或者停产、交付能力下降、供应中断等，或者进出口政策出现重大变化，或者出现国际贸易摩擦，或者公司主要原材料价格受市场影响出现上升，将可能对公司原材料供应的稳定性、及时性和价格产生不利影响，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

此外，公司主要从上游基础化工或精细化工行业采购原材料，随着环保政策趋严，供应趋紧，原材料价格可能存在上涨的风险。

（五）安全环保风险

公司主要产品的生产过程为配方型复配工艺，以复配、混合、过滤等工艺为主，生产环节不存在高风险、重污染的情况。虽然公司严格遵守安全生产方面的法律法规要求，并针对生产过程中少量“三废”排放采取了相应的防治措施，但如果公司在生产经营过程中因操作不当、设备故障或其他偶发因素而造成安全生产事故，或者发生因环保设施故障、污染物外泄等原因导致的环保事故，将对公司的生产经营产生不利影响。

（六）存货管理风险

2023 年度、2024 年度、2025 年度和 2026 年上半年,公司采用上线结算方式的主要客户收入占比分别为 68.32%、61.08%、56.98%和 65.83%。公司根据客户需求将货物发往客户指定的仓库时，从库存商品转入发出商品。公司已与采用上线结算方式的客户约定发出商品的管理机制和保管、灭失等风险承担机制，但若双方对保管责任的界定不一致或者遇不可抗力导致的风险，公司发出商品面临减值的风险。

（七）半导体行业周期变化风险

目前公司产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域。受益于下游消费电子、计算机、通信、汽车、物联网等终端应用领域需求的持续增长，全球半导体特别是集成电路产业实现了快速发展。根据 WSTS 最新预测，2026 年全球半导体市场规模将达到 1.655 万亿美元，同比增长约 107.9%；2027 年全球半导体市场规模约为 2.142 万亿美元，同比增长约 29.4%。由于全球半导体行业景气周期与宏观经济、下游终端应用需求以及自身产能库存等因素密切相关，如果未来半导体行业复苏不及预期或者市场需求因宏观经济或行业环境等原因出现下滑，将对公司经营业绩产生不利影响。

（八）全球国际贸易摩擦及不可抗力风险

基于目前国际关税政策的变动调整，公司可能面临供应链成本上升，双边贸易摩擦带来的供应链不稳定和需求下滑的风险。尽管公司主要生产基地位于金桥综合保税区且海外销售主要面向中国台湾地区，短期内关税直接影响有限，同时公司也在积极与下游客户配合加速国产化产品的导入。若全球经贸冲突持续升温，

叠加地缘政治风险，可能加剧供应链中断、成本上升以及下游客户需求不足的风险。

五、重大违规事项

2026年半年度，公司不存在重大违规事项。

六、主要财务指标的变动原因及合理性

2026 年半年度，公司主要会计数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,526,359,564.44	1,141,453,109.75	33.72
利润总额	590,742,162.50	405,413,558.09	45.71
归属于上市公司股东的净利润	531,763,849.95	375,634,437.13	41.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	425,764,261.57	356,742,258.28	19.35
经营活动产生的现金流量净额	320,311,282.50	245,107,216.99	30.68
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,842,808,026.18	3,530,948,564.12	37.15
总资产	5,869,190,684.04	5,038,433,221.10	16.49

2026 年半年度，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	2.38	1.72	38.37
稀释每股收益（元 / 股）	2.35	1.71	37.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.91	1.64	16.46
加权平均净资产收益率（%）	12.56	12.98	减少 0.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.06	12.33	减少 2.27 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	16.13	16.53	减少 0.40 个百分点

报告期内，公司实现营业收入 152,635.96 万元，较去年同期增长 33.72%，其中化学机械抛光液同比增长 29.47%，功能性湿电子化学品同比增长 51.03%。主要原因为公司产品研发创新能力得到持续加强。同时公司高效实施各产品线市

场拓展计划，积极推进新订单、新客户、新应用的获取，新产品、新客户、新应用的导入顺利，产品研发进展及市场拓展情况均实现预期。另外，公司部分产品顺利进入放量阶段，销售收入实现稳健增长。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 42,576.43 万元，较去年同期增长 19.35%，主要原因有：（1）报告期内，公司产品研发进展及市场拓展均实现预期，紧贴客户需求并同步客户上量节奏，推动营业收入稳健增长；（2）公司在持续加强研发投入的同时，持续提升内部管理和经营效率，报告期内期间费用增长幅度 30.18%，低于收入增幅，推动盈利能力提升；（3）报告期内，由于美元汇率的波动带来汇兑损失 5,512.67 万元，导致归母扣非净利润的增长有所影响。

归属于上市公司股东的净利润为 53,176.38 万元，较去年同期增长 41.56%。报告期内，计入非经常性损益的公允价值变动损益和投资收益税前金额为 12,467.57 万元，去年同期该类非经常性损益比较基数较小；受该因素影响，公司净利润的增幅高于扣非净利润增幅。

经营活动产生的现金流量净额为 32,031.13 万元，较去年同期增长 30.68%，本期销售回款和原材料购买支出与营业收入增长基本一致。

2026 年 6 月末，总资产较上年末增长 16.49%，其中流动资产增长约 14.23%，非流动资产增长约 20.87%。归属于上市公司股东的净资产较上年末增长 37.15%，一方面来自经营积累，另一方面系报告期内完成可转债转股，带来股本和资本公积的增长。

基本每股收益和稀释每股收益分别为 2.38 元/股和 2.35 元/股，较上期分别增加 38.37%和 37.43%，主要系公司净利润增加所致，稀释每股收益与基本每股收益的差异主要来自于可转债转股前和还在等待期的股权激励的影响。

扣除非经常性损益后的基本每股收益为 1.91 元/股，较上期增长 16.46%，体现了公司扣除非经常性损益的归母净利润和总股数的同步增长。

报告期内，公司的加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为 12.56%及 10.06%，较上期分别下降 0.42 个百分点和 2.27

个百分点，主要由于报告期内可转债转股，带来净资产短期的快速增长。

研发投入占营业收入的比例为 16.13%，较上期略下降 0.40 个百分点，研发投入金额同比增长 30.51%，主要系报告期内公司与客户紧密合作，把握技术趋势，积极开展各项研发活动，为公司可持续发展打好坚实基础。

综上，公司报告期主要财务数据及指标变动具有合理性。

七、核心竞争力的变化情况

2026 年半年度，公司核心竞争力未发生不利变化。公司核心竞争力体现在：

（一）深耕高端半导体材料领域

公司自成立之初就将自己定位为以科技创新及知识产权为本的高端半导体材料供应伙伴，始终围绕液体与固体表面微观作用和高端化学品配方核心技术并持续专注投入，成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品的垄断，并持续拓展和强化了电化学沉积领域的技术平台，产品覆盖多种电镀液及添加剂。

公司通过多年持续投入，已拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，成熟并广泛应用于公司产品中。截至 2026 年 6 月 30 日，公司及子公司拥有境内外授权发明专利 312 项。公司持续加强知识产权管理，通过了国家知识产权合规管理体系监督审核。公司通过完善的知识产权布局保护核心技术，持续创新并更新知识产权库，实现产品和技术的差异化，为公司开发新产品和开拓新业务创造了有利条件。

未来，公司将凭借在高端半导体材料领域积累的宝贵经验持续深耕，依托已有的先进技术平台和人才团队为客户提供高附加值的产品和服务。

（二）持续的研发投入和高效的产品转化

公司持续投入大量的资金、人力等研发资源，将重点聚焦在产品创新上，以满足下游集成电路制造和先进封装行业全球领先客户的尖端产品应用，已成为国内高端半导体材料行业领域的领先供应商。最近三年及一期，公司研发费用分别为 23,661.27 万元、33,276.59 万元、44,470.13 万元及 24,621.51 万元，累计占最

近三年及一期累计营业收入的比例为 17.74%，研发投入持续保持在较高水平。

公司致力于为集成电路产业提供以创新驱动的、高性能并具成本优势的产品和技术解决方案，从解决方案设计、产品研发、测试认证、供应保障、物流配套、技术支持等方面着手，提供全生命周期、全价值链的一站式服务。得益于有竞争力的商业模式，公司产品研发效率高且具有针对性。公司利用在化学配方、材料科学等领域的专长，持续研发创新产品或改进产品以满足下游技术先进客户的需求，将客户面临的具体挑战转化成现实的产品和可行的工艺解决方案。

（三）贴近市场和客户的服务模式

根据 SEMI 数据，2025 年中国台湾地区连续第 16 年保持全球最大半导体材料消费地区位置，2025 年销售额达 217 亿美元，中国大陆以 156 亿美元的销售排名第二。公司根植于全球半导体材料的第一大和第二大市场，布局富有经验的应用工程师团队在当地提供 7x24 小时服务。贴近市场和客户的服务模式有利于公司及时响应客户需求，运输时间短，运输成本低，并且与本土客户文化融合程度高，沟通效率高，具有较强的灵活性。

（四）可靠的产品及原材料供应能力

经过二十多年深耕积累，公司已掌握配方型电子化学品研发及产业化所需的产品配方设计原理、主要原材料采购及供应渠道、生产工艺流程操作、生产设备定制化选型设计及生产环境洁净度控制等关键要素，具备丰富的配方型电子化学品量产经验。同时，公司依靠先进的生产设备、成熟的工艺技术、完善的检测手段及 MES 系统将质量控制覆盖各个环节，确保产品质量的可靠、稳定，并获得了下游客户的广泛信任和认可，具备了可靠的产品量产及供应能力。

另一方面，公司在原材料采购及供应渠道方面积累了丰富的资源，与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作伙伴关系，并积极拓展供应资源。同时，公司通过已搭建的核心技术平台，纵向深入研究上游关键原材料，通过自建、合作等多种方式加快建立核心原材料自主可控供应的能力，拓宽供应品类，保障长期供应的可靠性。

（五）国际化、多元化的人才储备

通过多年的集成电路制造及先进封装领域的研发实践，公司组建了一批高素质的核心管理团队和专业化的核心技术团队。最近三年及一期末，公司研发人员数量分别为 264 人、307 人、409 人及 476 人，占员工总数的比重分别为 50.09%、50.66%、52.10%及 51.96%，研发人才队伍不断扩充。公司核心技术团队均由资深行业专家组成，在化学、材料化学、材料工程等专业领域有着长达几十年的研究经验，并在半导体材料行业深耕积累了数十年的丰富经验和先进技术。公司核心管理团队也在战略规划、行业发展、人才培养、团队建设、销售与市场、跨国公司管理等方面拥有丰富经验。公司管理团队在半导体材料及相关行业的丰富经验为公司的业务发展带来了全球先进乃至领先的视角。公司高素质的员工队伍为维持竞争优势提供了保证。

与此同时，公司持续加大后备人才引进和培养，整合优势资源，进一步提升公司整体综合实力。团队规模逐渐扩大的同时，团队能力培养初见成效，公司加大培训投入，在识别和分析公司人才需求的基础上，针对性地组织内外部培训、研讨交流会、知识分享会，始终贯彻了“终身学习”的理念，构建了结构化、多元化、体系化的学院式培训体系，有效提升员工的综合素质能力。

（六）规范的管理体系和卓越的运营能力

公司始终秉承“使命必达”的工作态度和服务宗旨，以高标准、严要求建立健全了以内部控制为中心的一系列政策体系、管理流程和机制，以全面防范应对各项风险危机。质量管控方面，公司围绕产品导入的全流程建立了成熟有效的产品质量保证体系，在产品研发、供应商管理、进料控制、过程控制、出货控制、客户服务、产品优化和迭代等方面进行全流程质量管控并已通过 ISO9001，ISO14001，ISO45001 等管理体系的第三方认证。报告期内，公司以高效、积极状态推进生产、运营高质量发展，不断加强研发、生产、质量、供应链等全流程管理，提升自动化和信息化水平，不断改进、完善并夯实 ESH 管理流程的落实和监管，在各项业务有序推进的同时，重大建设项目也按预期完成交付。

八、研发支出变化及研发进展

2026 年半年度，公司研发费用为 24,621.51 万元，较去年同期增长 30.51%，主要系为保持技术领先优势，加强产品研发创新能力，公司各项研发活动持续增

加，带来人力成本、股份支付和物料消耗等的增长。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司在研项目研发进展情况如下：

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	铜制程抛光液	先进制程用铜及铜阻挡层抛光液在多个客户端验证并稳定供应，用于更先进制程的铜及铜阻挡层抛光液在客户端验证进展顺利。用于成熟制程的迭代产品实现量产，并持续在更多客户端验证，进展顺利。	先进制程用的产品持续稳定供应。更先进制程用的产品满足客户工艺要求，通过验证，实现销售。用于成熟制程的迭代产品逐步实现自我迭代。	达到国际先进水平	产品满足成熟制程和先进制程的技术要求，具有成长空间。
2	钨抛光液	先进制程用钨抛光液多只产品组合实现稳定供应并逐步提升产量；同时相关产品已在多家客户端测试，进展顺利。用于成熟制程的产品根据客户的具体需求进行定制化开发，进一步满足客户需求，进展顺利。	紧跟客户在最先进制程领域的工艺发展步伐，全力研发适配国内前沿制程的配套抛光液，以精准满足客户需求，助力产业进步与供应链稳定。在成熟制程领域，将进一步聚焦成本优化，同步提升产品质量与客户满意度。	达到国际先进水平	产品满足成熟制程和先进制程的技术要求，具有成长空间。

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
3	基于氧化铈磨料的抛光液	基于氧化铈磨料的抛光液持续在多个客户端验证。持续为客户定制开发用于更先进制程的基于氧化铈磨料的抛光液,进展顺利。用于成熟制程的产品,实现量产并在更多客户端实现国产替代验证,进展顺利。	持续与客户合作,基于新产品或者先进制程逻辑芯片,存储芯片及3DIC抛光技术要求,客制化开发性能优越、品类丰富的抛光液;在存储芯片实现量产销售;在逻辑芯片,实现研发验证通过。 用于成熟制程的浅沟槽产品,实现量产并在更多客户端继续进行国产替代验证。	达到国际先进水平	产品满足成熟制程和先进制程的技术要求,具有成长空间。。
4	介电材料抛光液	用于先进逻辑芯片制程工艺的氮化硅抛光液满足技术要求,部分产品实现销售,更多产品持续在客户端验证;用于先进存储芯片工艺的氮化硅抛光液实现销售。氧化硅抛光液正在逐步实现研磨颗粒国产化,部分产品已经通过验证上线。持续开发和优化氮化硅抛光液并在客户端测试验证;开发具有更高性价比的氧化硅抛光液并在客户端测试验证。	用于先进制程的氮化硅抛光液实现量产。开发具有更高性价比的氧化硅抛光液并在客户端上线。	达到国际先进水平	逐步完善产品,扩大应用和市场份额。

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
5	硅及其他新材料新工艺用抛光液	硅抛光液产品已满足国内先进客户的技术需求，逐步扩大产能，确保供应稳定，同时进一步提升产品质量、优化生产成本。用于三维集成工艺的TSV，TGV铜及铜阻挡层抛光液、混合键合抛光液、聚合物抛光液在更多客户端作为首选供应商上线使用，逐步扩大销售，并持续与先进封装客户合作开发新工艺用抛光液。为客户定制开发的新材料用抛光液供应持续上量，配合客户定制开发的更先进制程用新材料用抛光液通过验证，实现销售。	硅抛光液拓展产品适用范围，塑造标杆产品，实现单一产品对多元客户需求的覆盖。持续与客户合作，完成新材料用抛光液和三维集成用抛光液的开发和测试，扩大应用。	达到国际先进水平	产品满足成熟制程和先进制程的技术要求，具有成长空间。持续扩大应用和市场份额。
6	功能性湿电子化学品	用于先进技术节点的刻蚀后清洗液、抛光后清洗液，在客户端持续扩大销售。同时，下一代新技术新需求产品开发验证及基础材料研究进展顺利。用于成熟制程的更高性价比的迭代产品在客户端验证顺利，部分产品成功导入。在先进封装领域，进一步拓宽功能性湿电子化学品应用领域，光刻胶剥离液、刻蚀后清洗液、抛光后清洗液批量量产，新技术需求产品持续开发验证中。	持续与客户合作，完成应用于先进技术节点、先进封装的功能性湿电子化学品开发及产业化，成熟制程产品进行高性价比解决方案技术迭代。	达到国际先进水平	持续完善产品，扩大应用和市场份额。
7	刻蚀液	成功建立刻蚀液技术平台，与多个客户展开积极合作，研发及验证按计划进行中。其中部分产品进入量产。	开发适用于先进制程独特配方型刻蚀液，支持先进工艺发展。	达到国际先进水平	满足先进技术节点需求，市场前景广阔。

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
8	电镀液及添加剂	完善集成电路大马士革工艺及先进封装电镀液及添加剂产品线，先进封装电镀液及添加剂批量量产，集成电路大马士革工艺电镀液及添加剂、硅通孔工艺电镀液及添加剂进入量产阶段，先进封装锡银电镀液及添加剂等研发及验证按计划进行。	完善电化学镀技术平台，开发满足集成电路大马士革工艺、硅通孔及异质集成技术等电镀液及添加剂并进行产业化。	达到国际先进水平	满足集成电路大马士革工艺及先进封装需求，市场前景广阔。
9	高端纳米磨料	自产氧化铈磨料应用于公司基于氧化铈磨料的抛光液产品，在先进制程工艺测试论证进展顺利，多款搭载自产氧化铈磨料的抛光液产品已通过客户端验证并实现量产销售，供应量呈持续增长趋势。	持续与客户合作，基于先进制程逻辑芯片和存储芯片抛光技术要求，客制化开发性能优越、品类丰富的自产纳米磨料颗粒。	达到国际先进水平	自产磨料颗粒满足成熟制程和先进制程的技术要求，与进口磨料互补，保障供应安全。

九、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

十、募集资金使用情况及是否合规

（一）以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至2026年6月30日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金已使用完毕。具体情况如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
一、募集资金总额	20,713.62
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	351.71
二、募集资金净额	20,361.91
减：	
以前年度已使用金额	19,490.06
本年度使用金额	1,300.76

项目	金额
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	1.61
加：	
募集资金利息收入	430.53
三、报告期期末募集资金余额	-

（二）发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
一、募集资金总额	83,050.00
减：直接支付发行费用	1,389.11
二、募集资金净额	81,660.89
减：	
以前年度已使用金额	43,588.65
本年度使用金额	6,952.79
现金管理金额	30,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.33
加：	
募集资金理财产品收益、利息收入	645.02
三、报告期期末募集资金余额	1,764.14

公司2026年半年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理使用制度》等相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十一、控股股东、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2026 年 6 月末，公司控股股东 Anji Microelectronics Co. Ltd.（以下简称“Anji Cayman”）直接持有公司股票 67,280,482 股，所持股份不存在质押、冻结的情况。2026 年上半年 Anji Cayman 不存在减持公司股份的情况。公司无实际控制人。

截至 2026 年 6 月末，公司董事、高级管理人员持有公司股份不存在质押、冻结的情况。2026 年 1-6 月，公司董事、高级管理人员直接持有公司股份的变动情况如下：

序号	姓名	职务	期初持股数（股）	期末持股数（股）	报告期内股份增减变动量（股）	增减变动原因
1	Shumin Wang （王淑敏）	董事长	89,682.00	116,587.00	26,905	分红送转
2	Zhang Ming （张明）	董事、总经理	134,186.00	174,442.00	40,256	分红送转
3	Yuchun Wang （王雨春）	副总经理	97,801.00	127,141.00	29,340	分红送转
4	杨逊	职工董事、 副总经理、 董事会秘书	122,241.00	158,913.00	36,672	分红送转
5	刘荣	财务负责人	14,282.00	18,567.00	4,285	分红送转

十二、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

以简易程序向特定对象发行股票项目保荐代表人：

保荐代表人：



康 杰



周 毅

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2026年 9 月 11 日

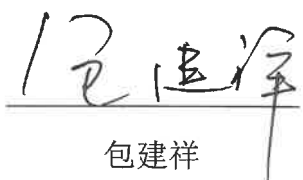
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐代表人：

保荐代表人：



康 杰



包建祥

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2026 年 9 月 11 日